

MODEL: MPS150A 探针台



产品图片中显微镜仅供参考，实际以客户最终配置显微镜为准

功能及应用范围：

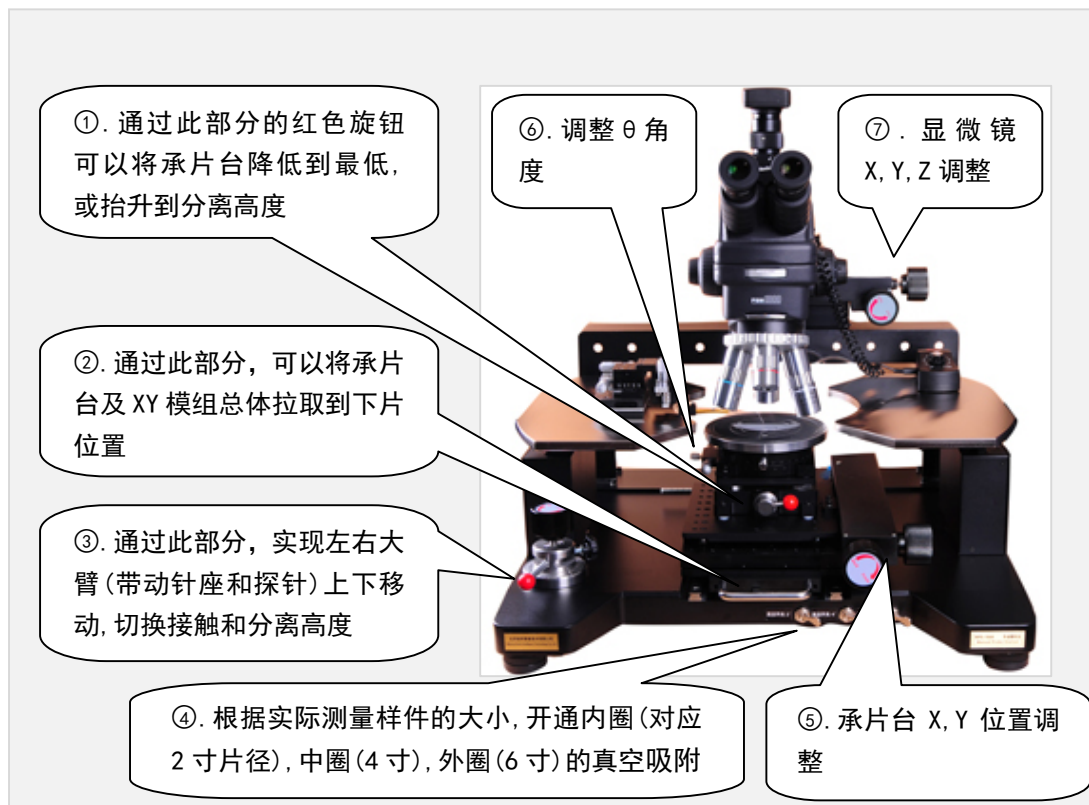
MPS150 设备是增强型手动分析探针台，为各种半导体芯片、微波器件等提供光电参数测试分析等能；设备可以吸附多种规格的芯片；并提供三维可调的探针测试针座及探卡测试针座。适用于大学、实验室、大生产线对芯片进行科研分析、抽查测试等用途。

技术参数：

项 目	性能指标
总体尺寸	900mm(横宽)*900mm(纵长)*600mm(高)
可测圆片尺寸	2" 、4" 、6" 、碎片

工作台行程		160mm×160mm
承片台 (三维调节) (θ 可调节)	Z 向接触/分离	行程 10mm, 10 μ m 分辨率
	θ 向微调范围	$\pm 5^\circ$ 微调 (360° 粗调)
	吸片方式	真空吸附
	分档	2"、4"、6" 单独真空吸附, 三档可选
针座平台	升、降行程	25mm
	接触/分离	0.33mm
上、下片方式		快速抽屉式上、下片
观察机构 (三维调节)	显微镜调节	X、Y 方向 ± 25 mm, Z 方向 35mm
	显微镜 (金相显微镜)	标配双目体视显微镜, 光学倍率 0.7X—4.5X 连续变倍 配金相显微镜时, 放大倍率可到 1000X
	照明	LED 亮度可调环形灯
外形尺寸		610mm×560mm×500mm (长×宽×高)
设备重量		约 40 KG
使用环境	电源	AC 220V $\pm$ 22V 50Hz $\pm$ 1Hz
	功率	0.05kW
	真空	-80 KPa
	环境温度	15°C—30°C
	相对湿度	<60%

使用方法



[A-上片]

1. 关闭可能的真空吸附(利用上图的④部分关闭真空吸附);
2. 利用上图的①旋钮, 将承片台降低到最低;
3. 利用上图的②指示部分, 将承片台连同下方的 XY 基座拉出到上下片位置;
4. 将芯片放置到承片台的中心;
5. 利用上图的②指示部分, 将承片台连同下方的 XY 基座推入到测量位置;
6. 利用上图的⑥指示部分, 调整承片台的 θ 角度, 通过显微镜观察, 确保水平;
7. 利用上图的①指示部分, 将承片台抬升到分离高度。

[B-下片]

1. 关闭可能的真空;
2. 利用上图的①旋钮, 将承片台降低到最低;
3. 利用上图的②指示部分, 将承片台连同下方的 XY 基座拉出到上下片位置;
4. 取下芯片;
5. 利用上图的②指示部分, 将承片台连同下方的 XY 基座推入到测量位置 (即收纳位置)。

[C-XY 轴移动]

利用上图的⑤指示部分, 调整承片台的 X, Y 位置。

特别注意: 移动承片台的 XY 轴, 要首先确保承片台在分离高度, 或者是最低高度, 如果在接触高度移动 XY, 可能导致探针划伤芯粒。

[D-探针接触, 分离]

芯粒放置到探针正下方后, 利用上图③指示部分, 切换分离高度和接触高度 (接触高度时, 探针将接触到待测芯粒)。

[E-承片台降低到最低]

利用上图的①旋钮, 可以将承片台降低到最低。

[实际测量流程]

1. 执行 E 步骤, 将承片台降低到最低;
2. 执行 A 步骤, 上片;

3. 执行 D 步骤，接触探针；
4. 电表测量；
5. 执行 D 步骤，分离探针；
6. 执行 C 步骤，切换到下一个芯粒；
7. 利用 D 步骤，接触探针；
8. 以此反复 3-7 环节，测量直至测量完毕；
9. 利用 B 步骤，下片。

优势分析

- 我有多年的探针台研发和实时经验，设备外观和精度均达到国内一流水平。
- 设备的丝杠、导轨，均采用台湾上银产品，精度高，不生锈。
- 承片台抽屉式设计，方便用户上下芯片。
- X, Y 调节在同一个位置，方便右手单手操作。
- 左手从 XY 位置调节释放出来，左手专门用于调整针座的接触分离高度，切换探针同芯粒的接触和分离，有较好的便捷性。
- 承片台、针座、显微镜部分，均采用三维可调节设计，方便灵活使用。

软件定制

我公司有专门的软件开发团队，可为您量身定做各类源表，各类测量表的测量控制、数据采集、数据分析软件。

配件信息

- 根据用户需求，提供多种可选规格的三维针座。
- 根据用户需求，提供多种可选规格的探针、支持探针定制。
- 根据用户需求，提供专业的测量线缆、线缆接头。